

ＯＲＩＳＴ技術交流セミナー（和泉センター）（通算 第28回）

**大阪技術研ベテラン研究員による、役立つ！ものづくり基盤技術・交流セミナー（第3回）**

**セラミックスの製造プロセス**

**～大阪技術研和泉センターでの開発事例を交えて～**

**～**

**主催：ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジネスセンター大阪）、地方独立行政法人大阪産業技術研究所**

開催日　 平成29年　１０**／２４（火）**

時　間　 **18：30～20：00**（セミナー） **20：00～21：00**（交流会）

場　所 クリエイション・コア東大阪　北館3階　309号室

東大阪市荒本北1-4-17 （近鉄けいはんな線「荒本駅」下車5分）

**講師：　応用材料化学研究部　部長　垣辻 篤**

ファインセラミックス製品は、原料粉末を合成し、その後の成形過程に合致するように調製した後、各種手法により形状を付与した後に焼結することによって製造されていることはよく知られております。本セミナーではこの製造プロセスに沿って詳細に、かつ、講演者が旧大阪府立産業技術総合研究所(現大阪技術研 和泉センター)にて取り組んできた研究事例 －高強度アルミナ（原料粉末合成）、BIP成形（成形技術）、HIP反応焼結、高熱伝導性複合材料ならびにセラミックス分散高強度材料（焼結技術）－　などを交えつつ解説致します。

講演は、基礎的な内容から最近の話題までお話しますので、企業の製造現場の方、研究開発、営業技術、経営者に至るまで、幅広い方を対象としています。講師は交流会にも参加しますので人的ネットワークづくりにもお役立て下さい。

**ものづくり中小企業、支援機関**

**定員 30名**（先着順）

**参加費無料**（交流会は1,000円）

「インターネット」または「FAX（下記の申込書に記載）」

※インターネットは、問合せ先のホームページにアクセスしてください。

ものづくりビジネスセンター大阪（小川・磯）　TEL：06（6748）1052

**お申込み**

**お問合せ先**

CHECK!

**MOBIO**

http://www.m-osaka.com

から「MOBIO Cafe開催案内」をご覧ください。

**参加申込書**

**ＦＡＸ ０６－６７４８－１０６２** ※お一人ずつお申し込みください。切り取らずこのままＦＡＸして下さい。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参加者氏名 |  | 企　業　名部署・役職 |  |
| 電話番号 |  | ＦＡＸ番号 |  |
| E-Mail |  |
| 住　　所 | 〒 |
| 交 流 会 | * 参加する　 　　　□　参加しない
 |

※ 交流会は20:00より、南館２階テラスにて立食・軽食スタイルで開催します。（会費1,000円）

※ 本講習会参加申込みにかかる個人情報は、主催者間で共有させていただきます。また、本申込書にご記入いただいた情報は、

　 本講習会の参加者集計、その他催事情報提供などの案内を行う目的のみに使用します。